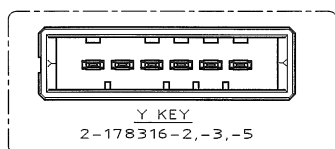
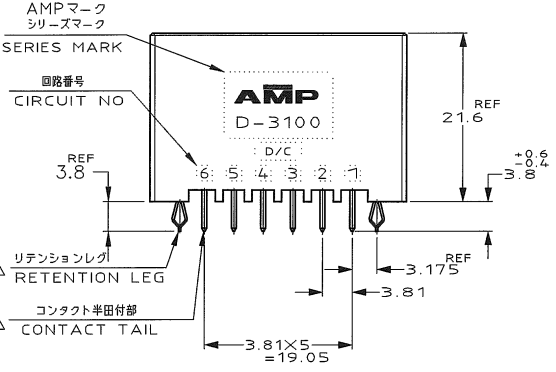
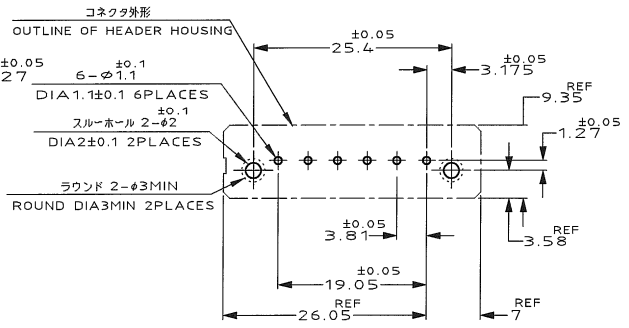
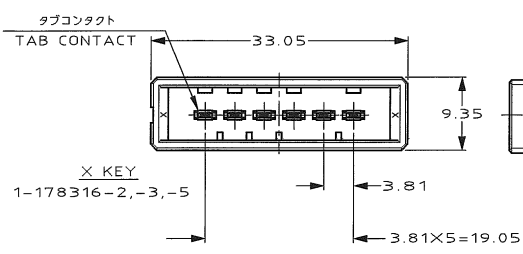


NUMBER 178316
 METRIC
 3rd ANGLE PROJECTION
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST
 AMP-J REV.10/93



推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
- △ FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △ FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN めっき
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN めっき
- △ めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- △ めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△	△	1,2-178316-5
△	△	1,2-178316-3
△	△	1,2-178316-2
(FINISH)	(PART NO.)	製品番号

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
-		-		ダイナミック 3100 シリーズ 6 極 ヘッドアップセンブリー (垂直タイプ) 6 POS SINGLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
C	REVISED (PJ00-0039-03)	T.S.	S.M.	3-23	25 APR 93
B	REVISED (PJ00-0114-03)	T.S.	S.M.	3-23	10 JAN 95
A	REVISED (PJ00-2103-95)	K.I.	S.M.	10 JAN 95	10 JAN 95
O	RELEASED (PJ00-1468-94)	K.I.	S.M.	10 JAN 95	10 JAN 95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	
			DR. K. IKEDA DE. 22/DEC/94		
			CHK. S. MANABE 10/JAN/95 APP. S. MANABE 10/JAN/95		
		SIZE		LOC	
		A3 J		NUMBER	
		SCALE		REV. C	
		2-1		SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面